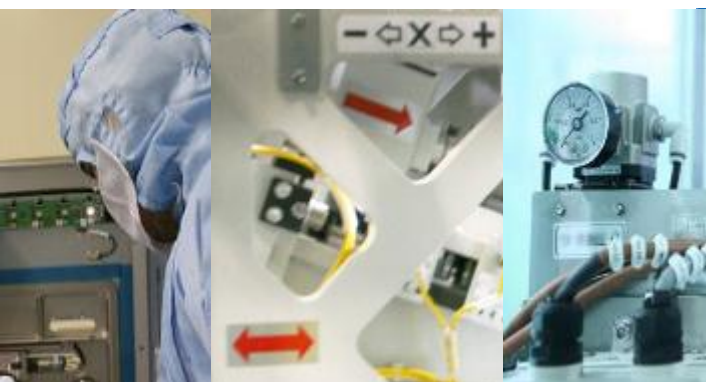


2013年3月期 決算説明資料

平田機工株式会社 2013.5.23



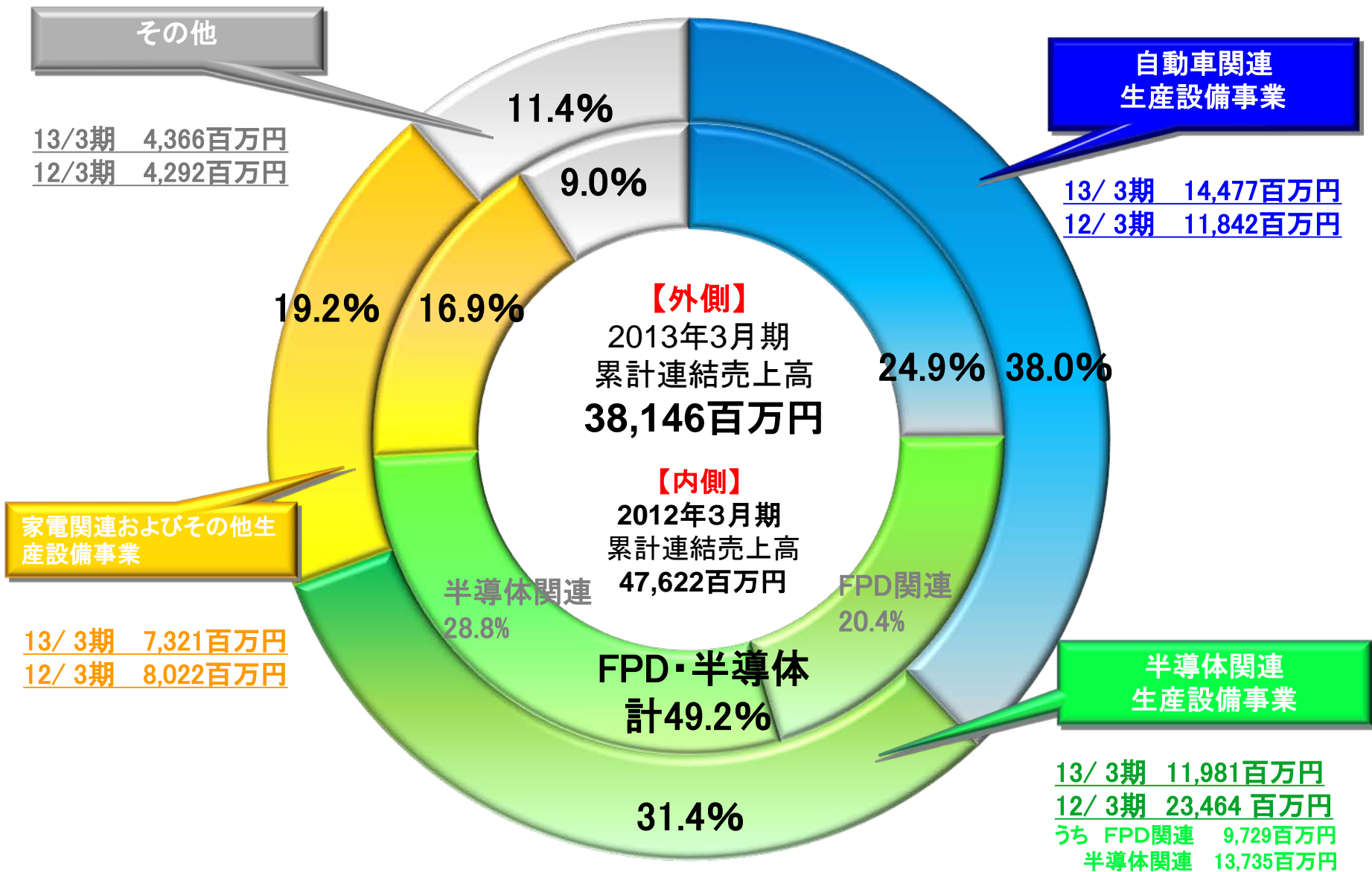
The Global Production Engineering Company
Hirata



I 決算状況

2013年3月期（2013年3月31日）

I 決算状況 事業部門別売上高構成比



決算概要

- 予定していた受注・売上案件の延期等により期初予想比では売上高、各利益とも減少し、3年ぶりの減収、2年連続の減益。
- 第3四半期まで損失計上が続いたが、第4四半期に売上高が大きく伸長した結果、各利益とも黒字計上。
- 単体では赤字計上。一部海外子会社の好業績が連結決算での黒字計上に寄与。

連結決算

(単位:百万円)

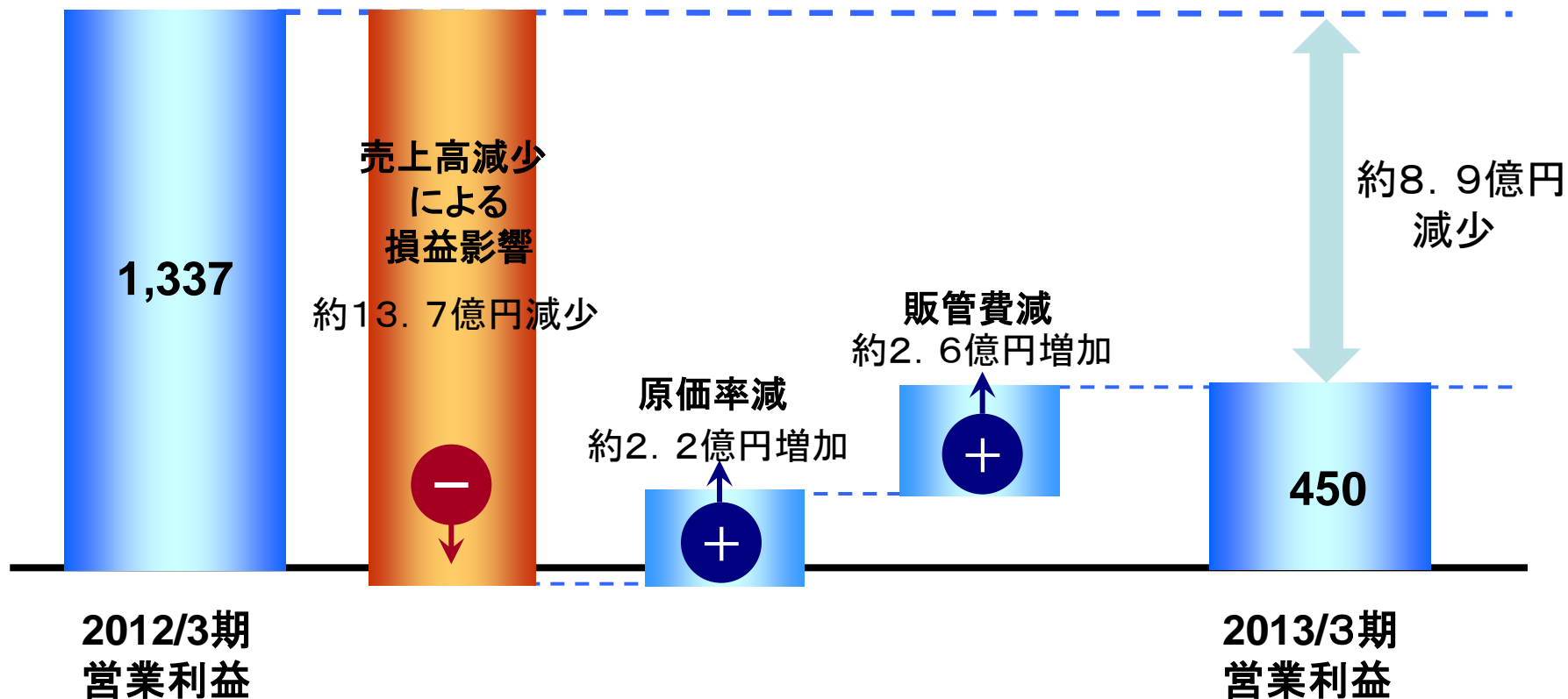
項目	2012年3月期 実績	期初 通期連結業績予想	2013年3月期		
			実績	達成率 (対期初予想)	前期比 増減率
売上高	47,622	49,000	38,146	77.8%	△19.9%
営業利益	1,337	1,500	450	30.1%	△66.3%
経常利益	1,464	1,300	394	30.4%	△73.1%
当期純利益	489	800	284	35.6%	△41.8%

単体決算

項目	2012年3月期 実績	期初 通期個別業績予想	2013年3月期		
			実績	達成率 (対期初予想)	前期比 増減率
売上高	38,575	39,000	28,162	72.2%	△27.0%
経常利益	1,160	1,000	△259	—	—
当期純利益	266	650	△92	—	—

I 決算状況 営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



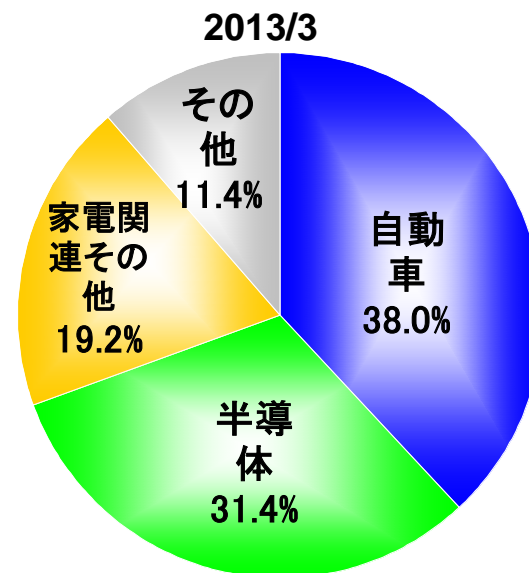
■ 一部案件の遅れなどあったが、自動車関連の大型案件の売上などが収益に寄与。

- ・ 自動車関連設備：一部案件が遅れたが北米メーカーの大型案件を中心に期末にかけて売上が伸びた。
- ・ 半導体関連設備：製造受託案件の売上により一定の水準を確保。
- ・ 家電関連およびその他設備：家電、タイヤ共に比較的小規模な案件が多く、低調。

事業部門別売上高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3
自動車	14,477
半導体	11,981
家電関連その他	7,321
その他	4,366
合計	38,146



【注】13/3期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

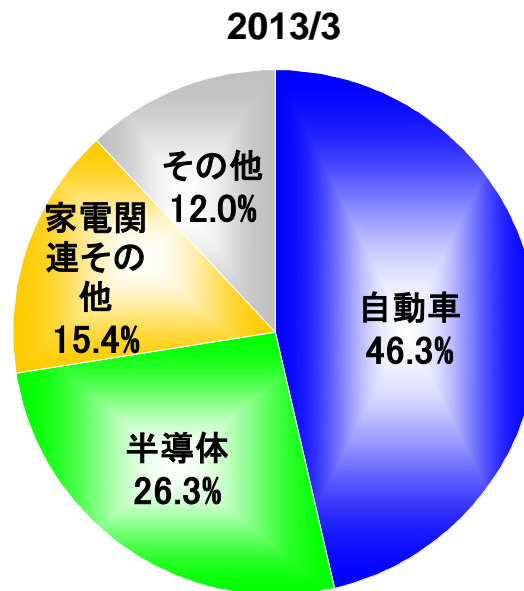
■ 厳しい受注環境が続く中、自動車関連は北米メーカーを中心に堅調。

- ・ 自動車関連設備：北米メーカーの各国拠点への設備増強が続き、その受注を確保したことで堅調に推移。
- ・ 半導体関連設備：大型案件の受注が少ない厳しい環境が続き、低調に推移。
- ・ 家電関連およびその他設備：家電、タイヤ共に大型案件が少なく、低調。

事業部門別受注高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3
自動車	17,914
半導体	10,145
家電関連その他	5,937
その他	4,655
合計	38,652



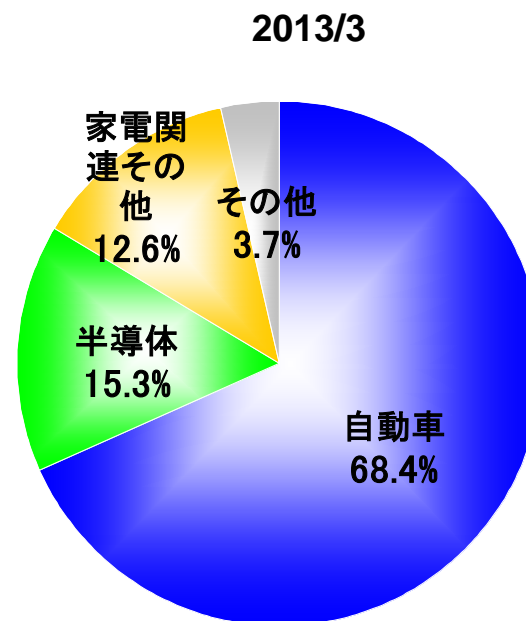
【注】13/3期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

- 自動車関連は大型案件が多く高い水準を維持。他の事業分野は低調。

事業部門別受注残高の状況

単位: 百万円

事業部門	2013/3
自動車	13,681
半導体	3,062
家電関連その他	2,518
その他	738
合計	20,001



【注】13/3期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

GM社から2年連続でSupplier of the Year受賞

2013年3月13日、米国自動車会社 General Motors Company(以下「GM社」)から2年連続でSupplier of the Yearを受賞しました。

GM社は、1992年から毎年、同社に部品や設備などを供給する世界中のサプライヤーの中から、特に同社に多大な貢献をしたと評価した企業を表彰しています。

2012年のサプライヤー・オブ・ザ・イヤーは、世界にあるGMのサプライヤー約18,500社のうち、1パーセント未満の会社のみ受けることができ、各社とも、革新的な技術、優れた品質、タイムリーなクライシス・マネジメント、競争力のある全社最適型コスト解決法などが評価されました。

今回はアSEMBリーおよびテスト装置の部門においての受賞です。



Ⅲ 市場動向および2014年3月期業績の見通し

2013年3月期（2013年3月31日）

◆自動車関連市場

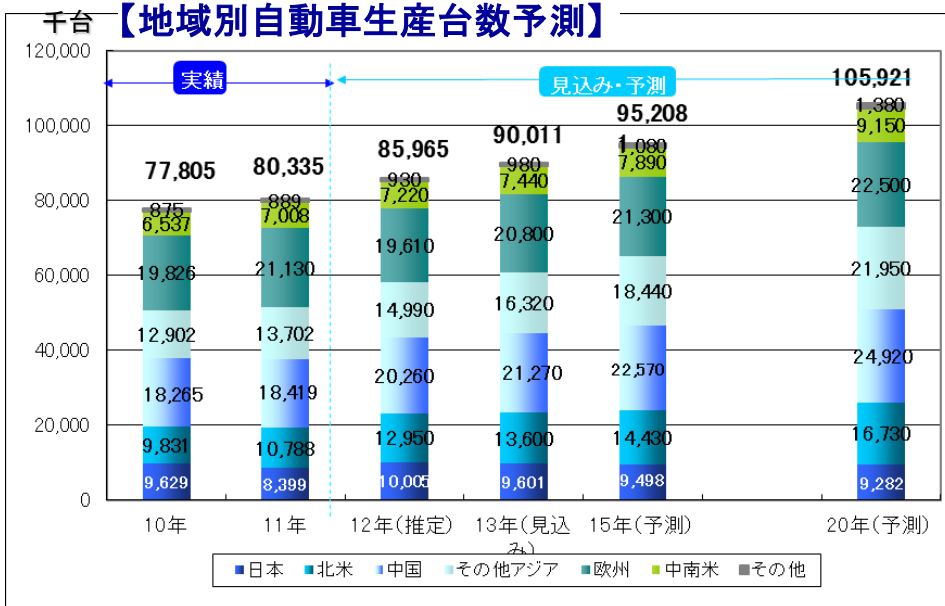
■金融不安の続く欧州市場には不透明感が払拭できない中、北米、中国、インド他、世界の自動車生産台数は増加が続く見込み。

■北米自動車メーカーは好調を持続。震災以来低調だった国内メーカーもハイブリッド車など堅調で回復基調。

●当社の今期見込み
北米自動車メーカーからの更なる受注拡大を図り、各社が中国、南米等、世界各国で展開する事業戦略に沿って事業を推進する。

出所 上段グラフ:調査会社S社資料
下段グラフ:2013年版 HEV、EV関連市場徹底分析調査 (株富士経済)

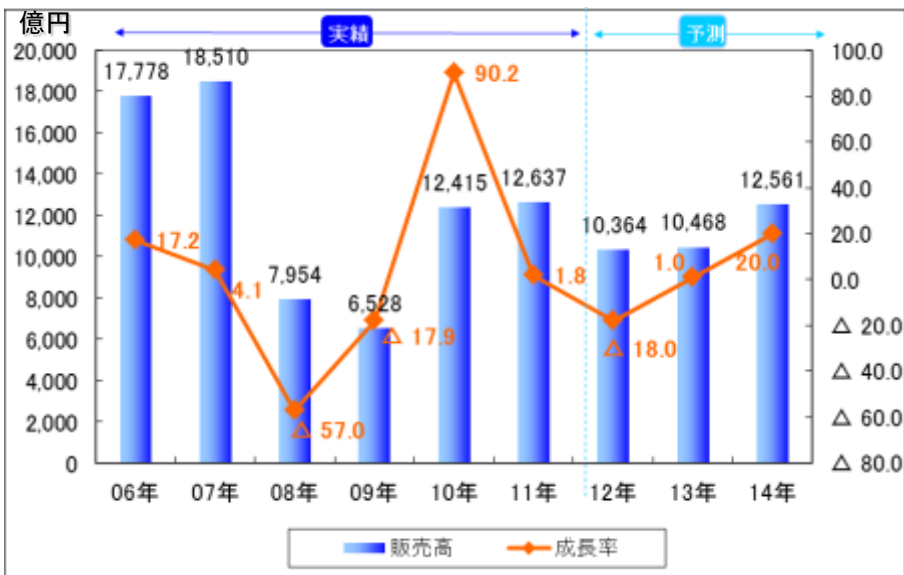
【地域別自動車生産台数予測】



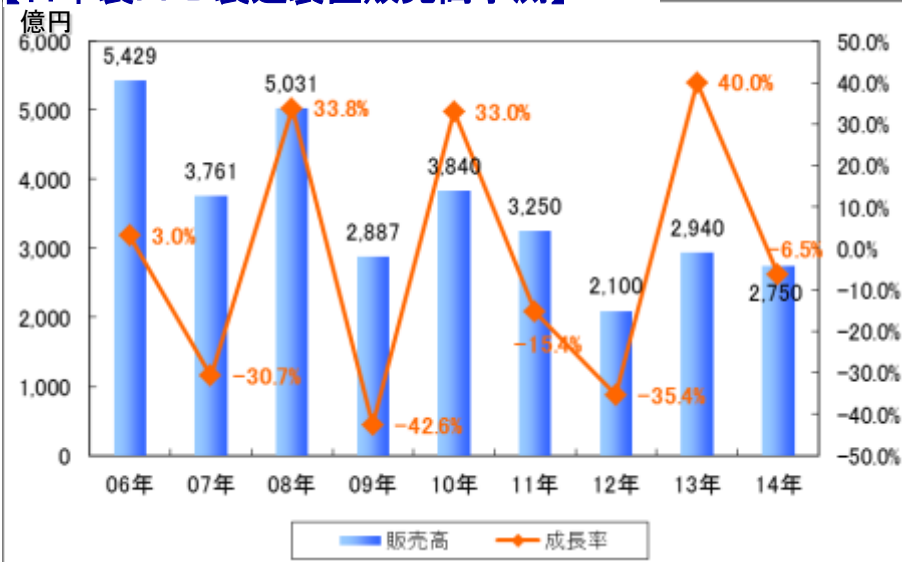
【電気自動車等環境対応車予測市場規模予測】



【日本製半導体装置販売高予測】



【日本製FPD製造装置販売高予測】



◆半導体・FPD関連市場

■半導体関連は、スマートフォン、タブレット端末の好調さに反し、PCの低迷が続き、メモリの受給悪化が続く。

■FPD関連は、テレビ需要は低迷するものの、スマートフォン、タブレット端末向けの高成長が継続する見込み。

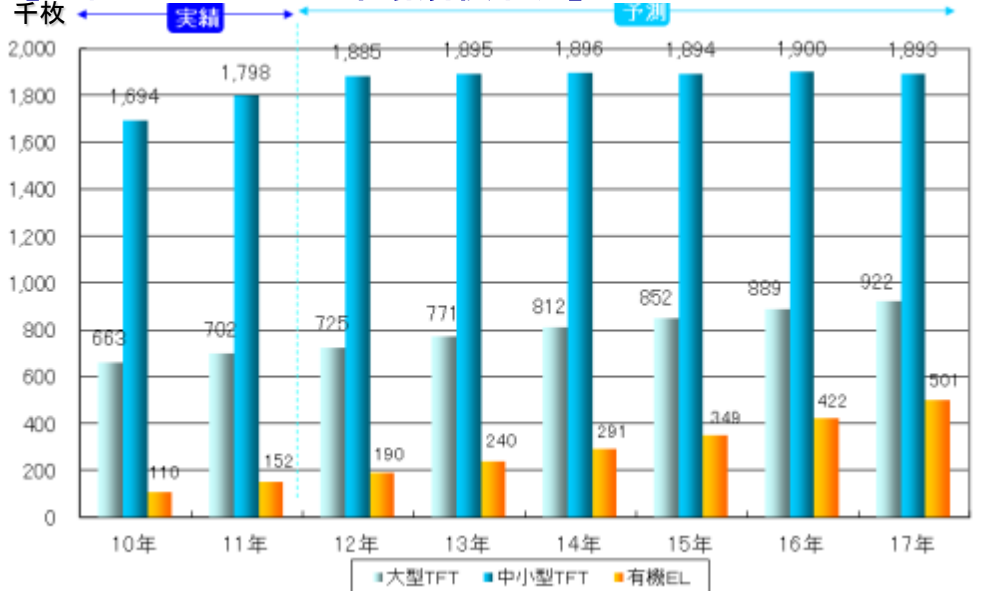
●当社の今期見込み

半導体関連は、継続して取引のある国内外の装置メーカー、デバイスメーカーからの受注が期待できるが受注額の低下が懸念される。

FPD関連では、スマートフォン、タブレット端末向けパネル用の塗布・切断・貼合装置の営業展開を促進する。

出所:半導体・FPD製造装置需要予測(2012年度～2014年度)
(一般社団法人日本半導体製造装置協会)

【ディスプレイパネル市場規模予測】



◆有機EL関連市場

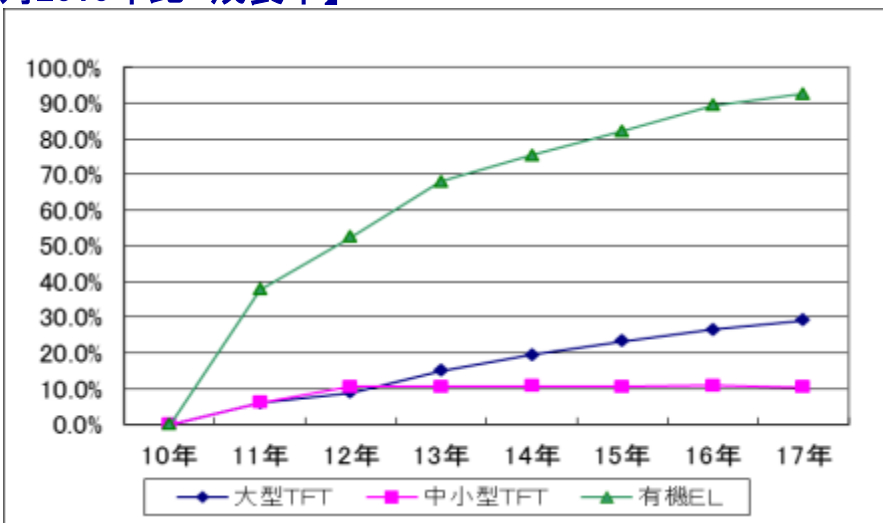
■液晶パネルの需要は大型・中小型共に成長が鈍化するのに対し、有機ELパネルは極めて高い成長が続く見込み。

■ディスプレイ用のみならず照明用途の開発も進んでおり、韓国、日本、台湾などの各メーカーの競合が更に激化する見通し。

●当社の今期見込み

今後の需要拡大に合わせ、製造受託案件の更なる受注拡大を見込む。

【対2010年比 成長率】



出所: 2012ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査 (株富士カメラ総研)

◆家電市場

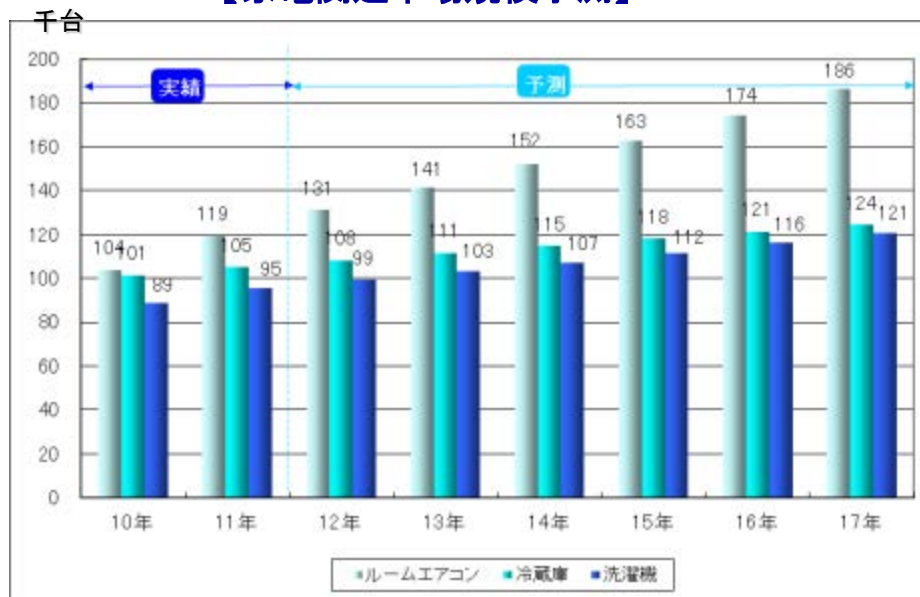
■家電関連は、特に中国など新興国の都市化を背景にルームエアコン等の需要が拡大し、堅調な成長が続く見込み。

●当社の今期見込み
掃除機関連の設備等の引合いが増え、受注増が期待できる。また、アジア圏の関係会社の営業力・生産力の強化により白物家電関連の更なる受注拡大に取り組む。

◆その他

●当社の今期見込み
住宅関連生産設備などの引合いが増えており、受注拡大を図る。

【家電関連市場規模予測】



出所:2012ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査
(株富士キメラ総研)

(単位:百万円)

	上期	下期	通期
売上高	22,000	20,000	42,000
自動車関連	9,000	8,500	17,500
半導体関連	5,500	6,000	11,500
家電関連およびその他	5,000	3,000	8,000
その他	2,500	2,500	5,000
営業利益(率)	500 (2.3%)	200 (1.0%)	700 (1.7%)
経常利益(率)	400 (1.8%)	100 (0.5%)	500 (1.2%)
当期純利益(率)	250 (1.1%)	50 (0.3%)	300 (0.7%)

営業・受注体制 の強化

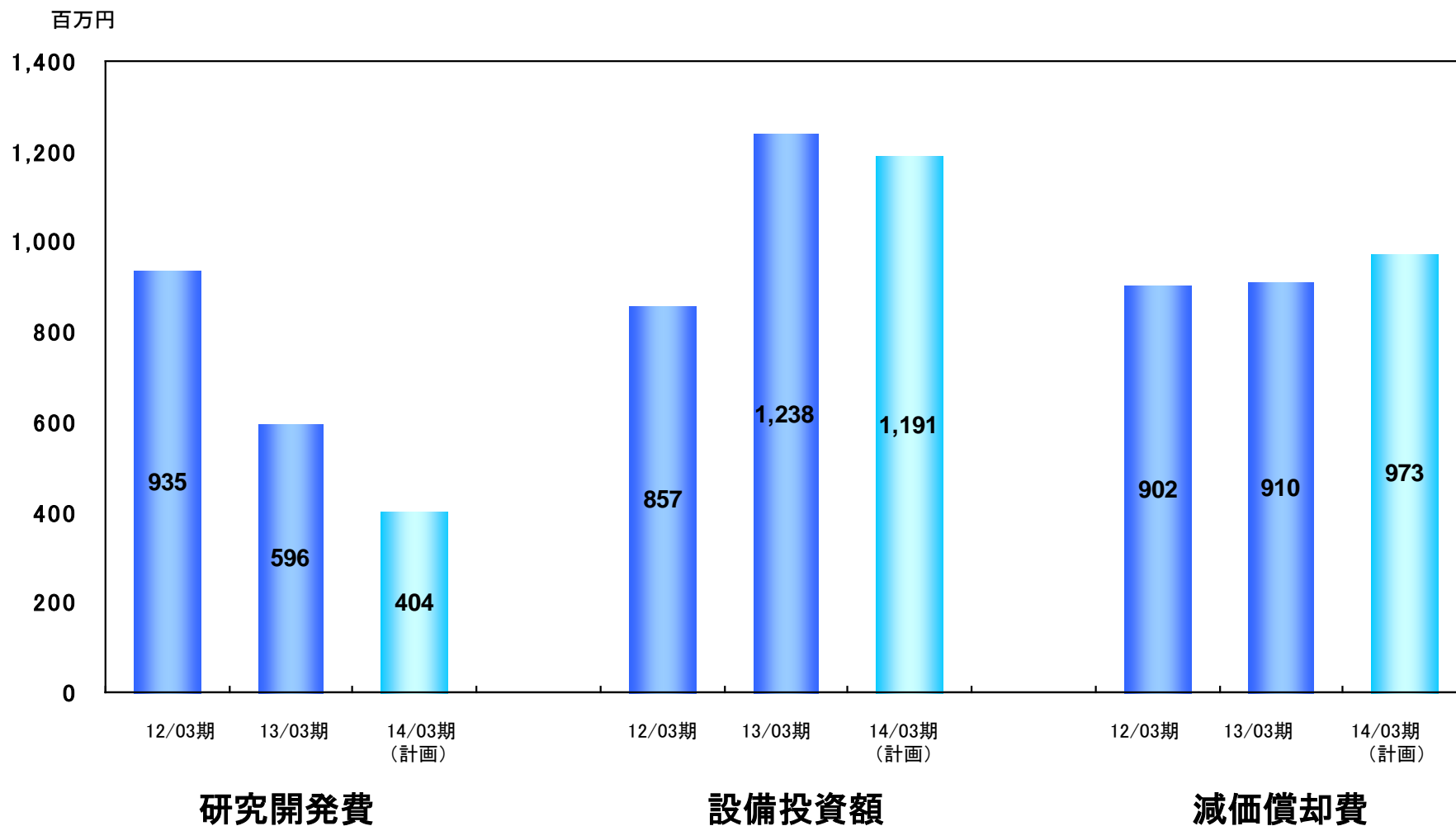
1. 自動車関連:お客様との連携強化。
2. 半導体関連:既存顧客への密着した営業、北米市場への展開。強化ガラス切断装置の販売拡大。
3. 家電関連その他:アジア市場での受注拡大。

生産効率 の向上

1. 国内拠点人員の機動的な配置の実行。
2. 国内・海外グループの連携による生産の最適化。

新事業領域への参入 商品開発の加速

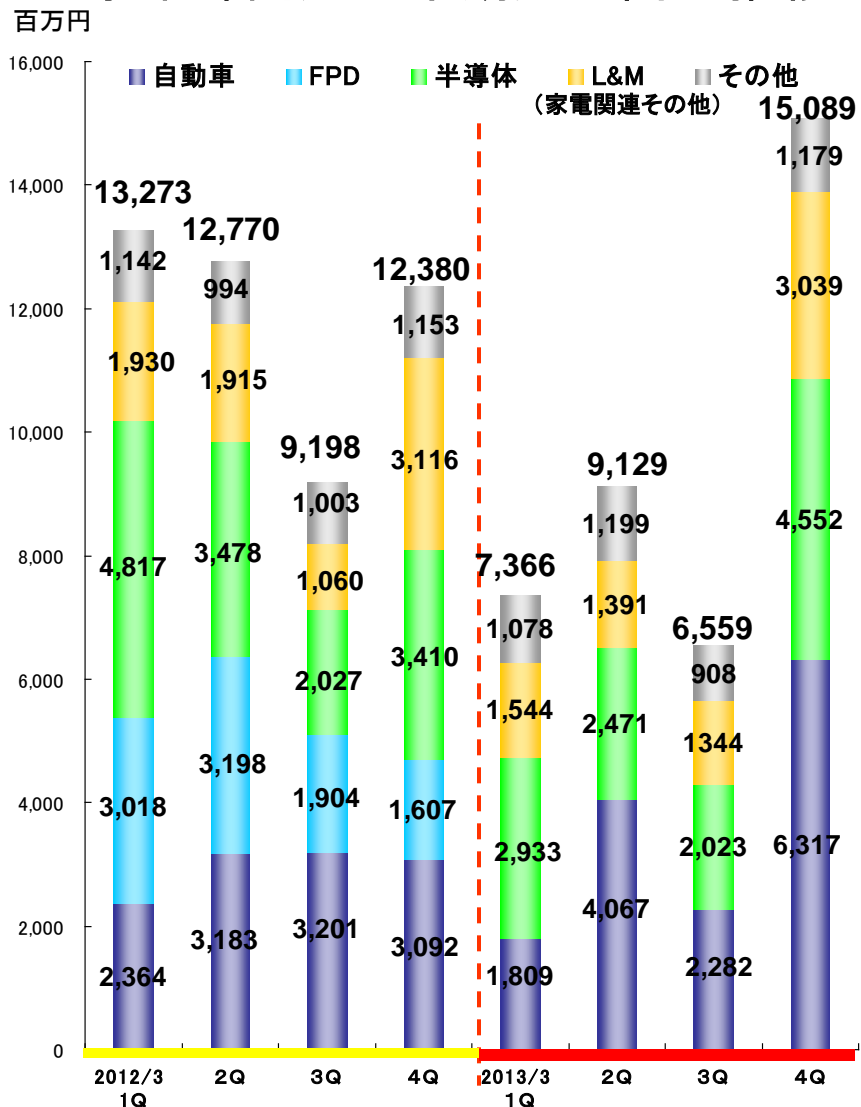
1. 真空製造装置の製造受託対応強化。
2. 高速、高精度、機種変更機敏に対応できるハンドラーの市場投入。
3. 既存技術の新領域への展開。



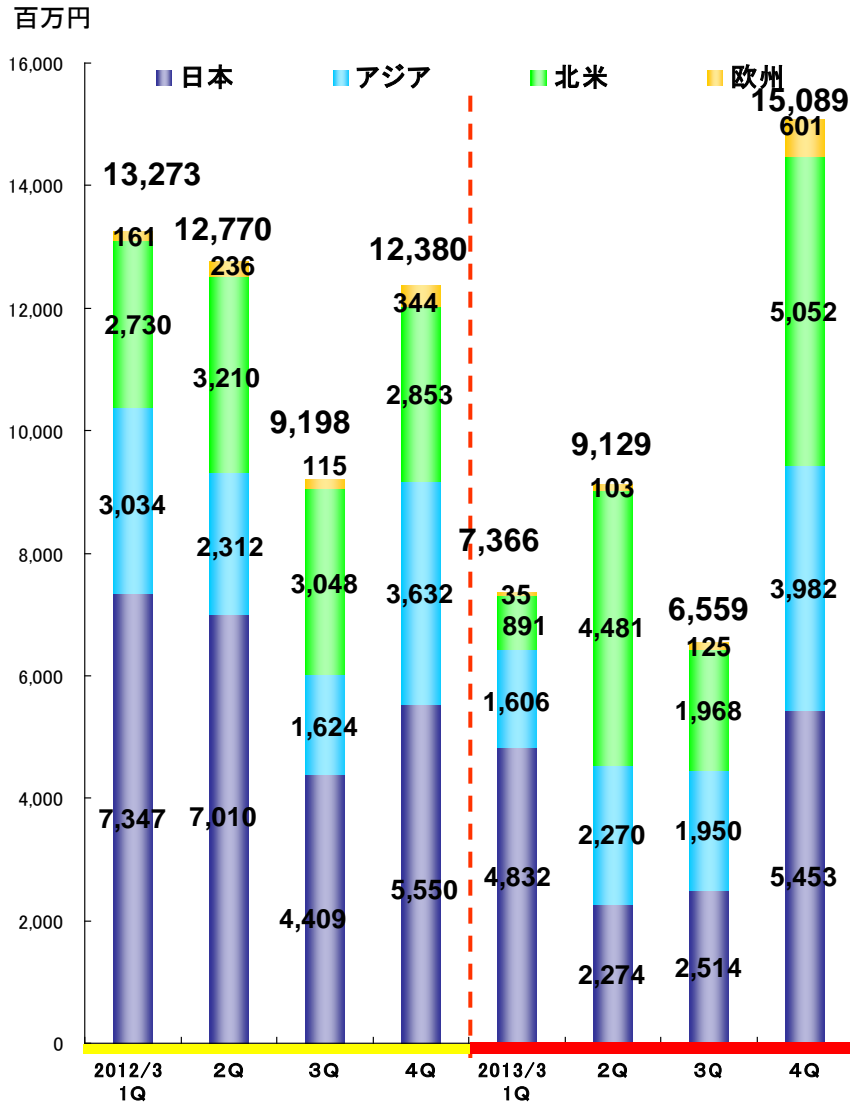
V 参考資料

2013年3月期（2013年3月31日）

事業部門別四半期売上高の推移

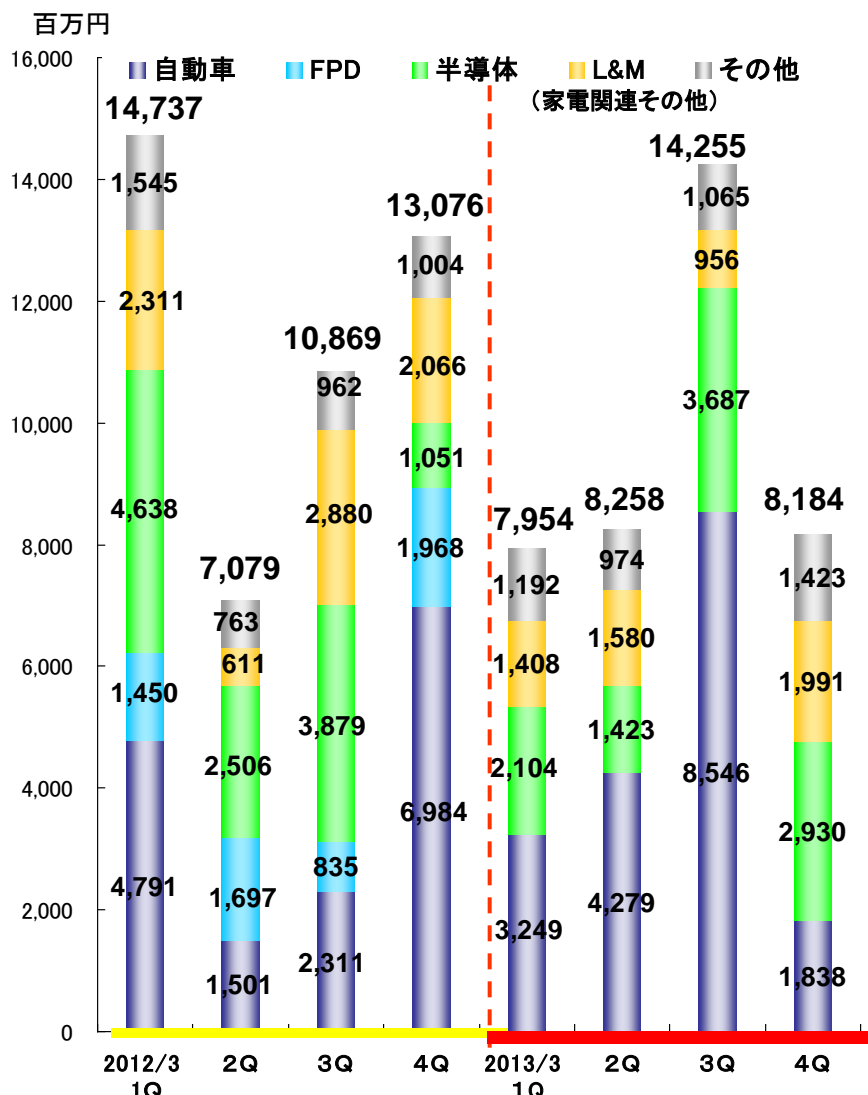


地域別四半期売上高の推移

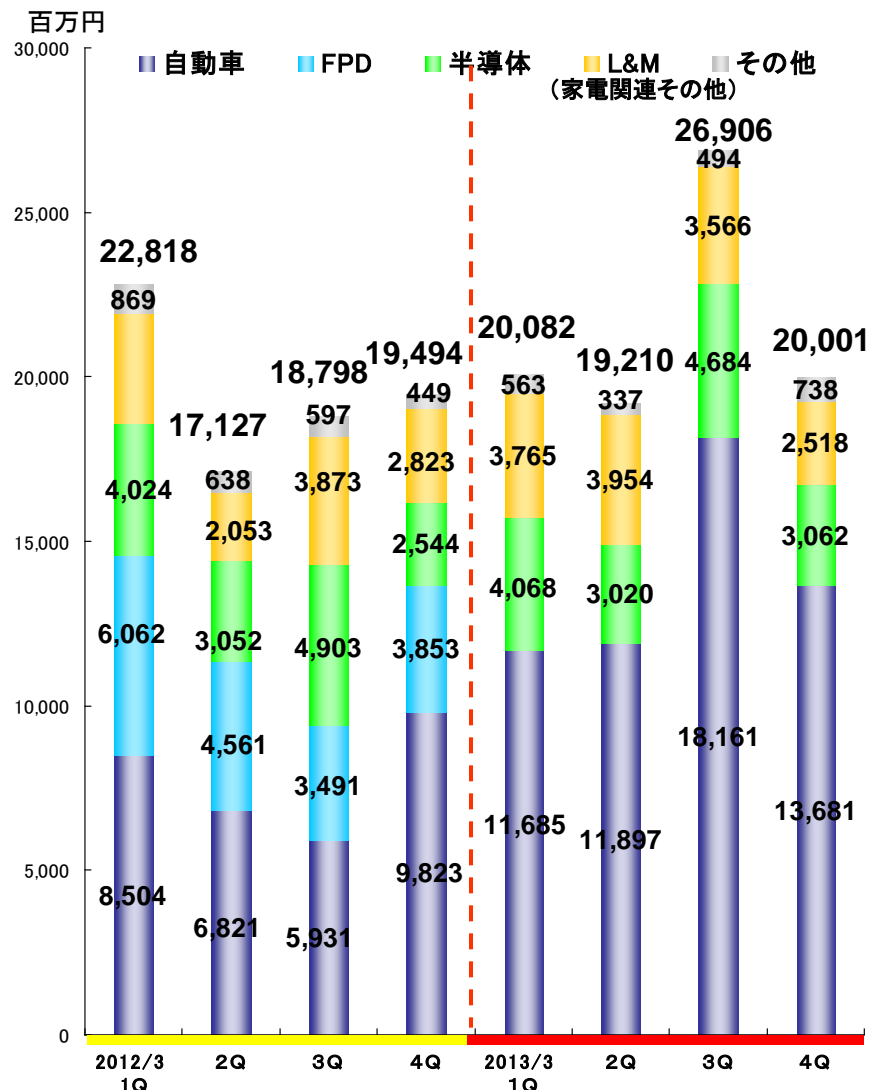


【注】2013年3月期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

事業部門別四半期受注高の推移



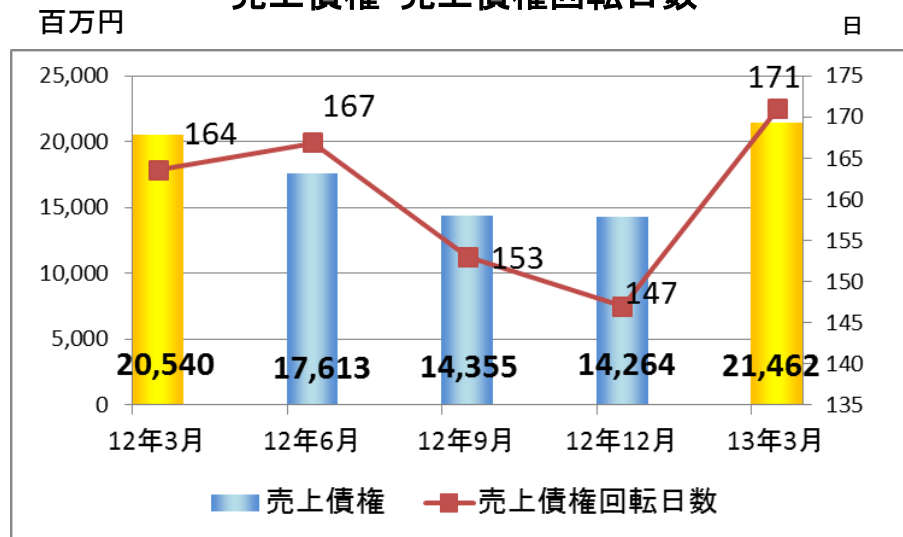
事業部門別四半期受注残高の推移



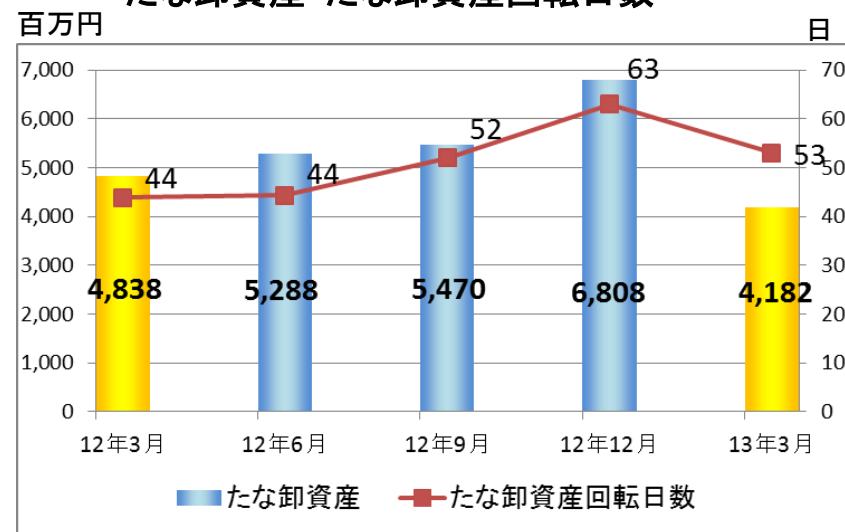
【注】2013年3月期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

IV 参考資料 主要指標

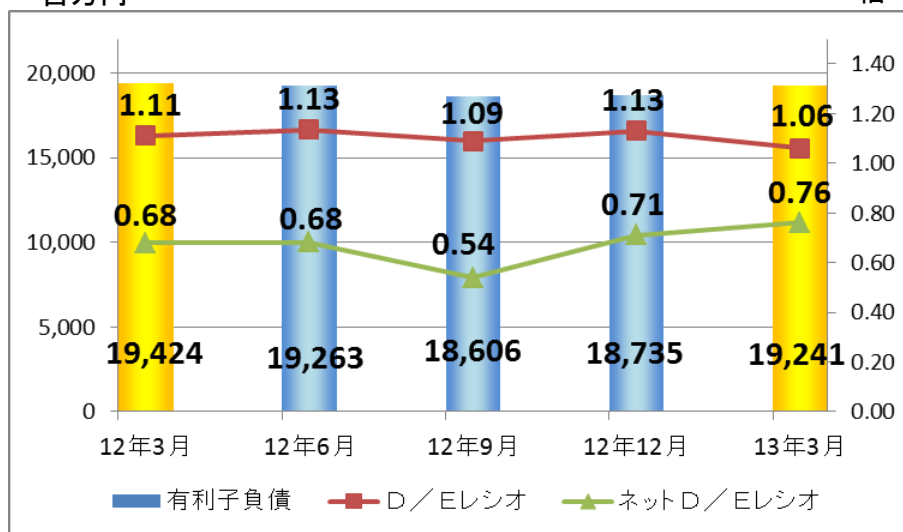
売上債権・売上債権回転日数



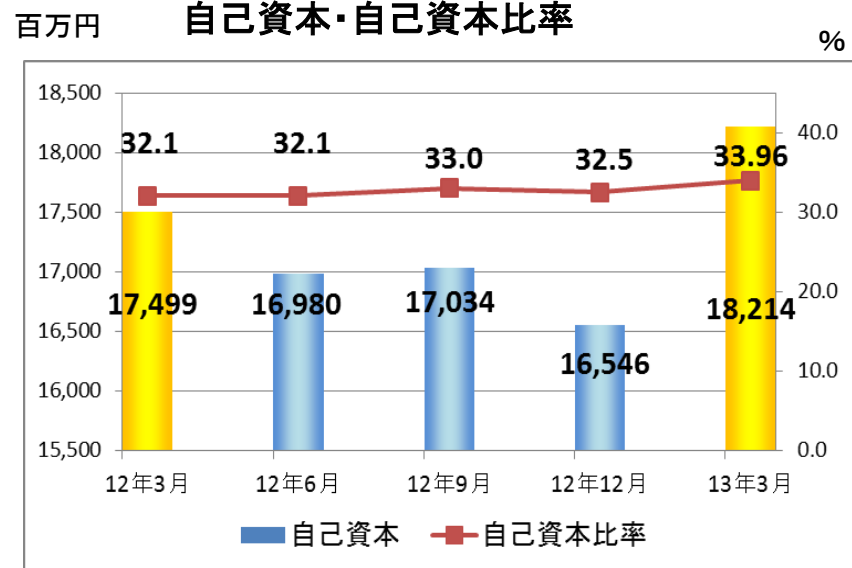
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期の期中平均値にて算出しております。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることあることをご承知おきください。